

Fujitsu stellt neues Bluetooth®-Funkmodul für Embedded-Anwendungen vor

01.01.2004, 10:00 | Industrie, Bau & Immobilien

Pressemitteilung von: *Fujitsu Microelectronics Europe*

Fujitsu stellt neues Bluetooth®-Funkmodul für Embedded-Anwendungen vor

PR801, Frankfurt 17. Februar 2004. Fujitsu Microelectronics Europe kündigt ein neues oberflächenmontierbares Bluetooth®-Funkmodul (gemäß Bluetooth® Version 1.1) an, das sich ideal für Embedded-Anwendungen eignet.

Das MBH7BTZ03 ist mit Abmessungen von 10 x 9,5 x 1,9 mm sehr kompakt. Es verfügt über ein UART-Hardwareinterface, einen High-Rank-Protocol-Stack (L2CAP, SDP, RFCOMM) sowie GAP-, SPP- und DUN-Profiles, um die Belastung für die Host-CPU zu verringern. Der Anwender hat die Wahl zwischen Host Controller Interface (HCI) und Serial Port Profile (SPP) Interface. Da in letzterem auch der obere Protocol-Stack für die serielle Kommunikation enthalten ist, erlaubt das Design beträchtliche Einsparungen im Bereich der Softwareentwicklung, was die Markteinführungszeit verkürzt und die Kosten senkt. Die Softwareschnittstelle ist als einfache, textbasierte Befehlssteuerung ausgeführt.

Das Modul der Leistungsklasse 2 arbeitet im 2,4 GHz ISM-Band (Industrial, Scientific, Medical). Es liefert eine Ausgangsleistung von maximal +4 dBm und hat eine Empfänger-Empfindlichkeit von -70 dBm. Es benötigt eine Versorgungsspannung von 2,2 bis 3,6 V und nimmt im Deep-Sleep-Modus lediglich 30 µA auf.

Von FME wurde ein Applikations-Board entwickelt, das ergänzend zum Bluetooth-Modul einen Fujitsu-Mikrocontroller und Speicher enthält. Prototyp-Boards befinden sich derzeit in der Testphase und werden in Kürze mit Software-Beispielen und Quellcode angeboten werden. Dies ermöglicht dem Kunden das Implementieren und Testen sehr schneller Standalone-Systeme (z.B. Handheld-Produkte oder andere mobile Geräte mit geringer Leistungsaufnahme für die drahtlose Kommunikation).

Es muss lediglich eine externe Antenne hinzugefügt werden, und schon lassen sich mit dem MBH7BTZ03 Bluetooth-fähige Produkte realisieren. Das Modul wird seit Dezember 2003 in großen Stückzahlen produziert.

Bluetooth ist ein Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. (USA) und ist an Fujitsu Limited lizenziert. Weitere Warenzeichen oder Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Ein zur Presseveröffentlichung gehörendes Bild mit mittlerer Auflösung finden Sie über den Link:
<ftp://ftp.jdk.co.uk/Fujitsu/Press/MRPR801.jpg>

Zum Downloaden eines Bildes mit höherer Auflösung verwenden Sie folgenden Link:

<ftp://ftp.jdk.co.uk/Fujitsu/Press/HRPR801.zip>

Kurzprofil Fujitsu Microelectronics Europe

Fujitsu Microelectronics Europe (FME) ist ein führender Lieferant von Displays und Halbleiterprodukten. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Systemlösungen für die Bereiche Automotive, Digital-TV, Mobile Kommunikation, Networking und Industriesegmente.

Die enge Zusammenarbeit der Entwickler aus den FME Design Centern - spezialisiert auf Mikrocontroller, Mixed-Signal, Wireless, FRAM, Multimedia ICs und ASIC Produkte - mit den Marketing- und Sales-Teams aus ganz Europa

trägt dazu bei, den Kunden-Anforderungen bei der Entwicklung von Systemlösungen gerecht zu werden.

Dies wird durch eine breite Palette von hochentwickelten Halbleitern, IP und Bausteinen unterstützt. Hochwertige LCDs und Plasma-Displays ergänzen das Produktportfolio. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Fujitsu Microelectronics Europe unter <http://www.fme.fujitsu.com>

Weitere Informationen:

Fujitsu Microelectronics Europe GmbH KEK

Kommunikationsagentur GmbH

Am Siebenstein 6-10 Wagnmüllerstraße 16

D-63303 Dreieich-Buchschlag D-80538 München

Telefon: 06103/690-0 Telefon: 089/21 99 01-18

Telefax: 06103/690-122 Telefax: 089/21 99 01-99

E-Mail: Jim.Bryant@fme.fujitsu.com E-Mail: estepken@kek-gmbh.de

Kontakte: Jim Bryant Evelyn Stepken

Weitere Informationen über Produkte von Fujitsu Microelectronics Europe GmbH finden Sie im World Wide Web unter unserer Adresse. <http://www.fme.fujitsu.com>

Portrait

News-ID: 30002 • Views: 2675 (Stand: 01.08.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/30002/Fujitsu-stellt-neues-Bluetooth-Funkmodul-fuer-Embedded-Anwendungen-vor.html>